

印刷線路及焊盤用導電銅膏

顯示器，智慧型手機等用途

用途

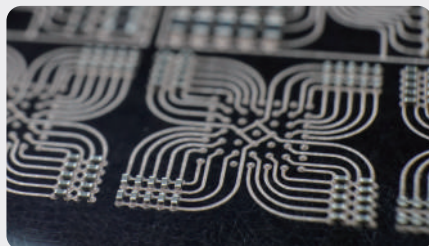
印刷線路和天線

以下其他用途外還有多項應用（如電子加熱器）

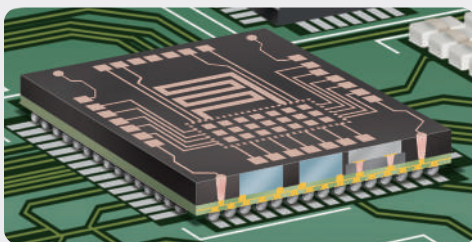
顯示器上 LED 線路連結



在玻璃基板上的印刷線路成形



可應用在半導體封裝 Compound 上印刷線路



主要特性

- 藉由可低溫固化的特性，可應用在 PET, COP, PEN 等不耐熱基材上。並和基材有**良好的密著性**。
- 可當作電鍍線路的**電鍍層作使用**。
- 可對應**印刷細線路**。(L/S: 75/75um)

產品型錄和特性表

產品型號			SW180	SW180T7	SW601
特性			細線路應用	薄膜化應用	柔軟彎折型
金屬粒子	種類		銀包銅粉		
	平均粒徑	μm	4 ~ 6	2 ~ 4	4 ~ 6
結合劑	種類		環氧樹脂		
金屬粒比率		wt%	91	92	89
黏度	BH型	dPa·s	1,300 ~ 1,700	1,000 ~ 1,400	
密度		g/cm^3	4.0	4.3	4.1
體積阻抗率	固化條件 130deg. C × 30min.	$\Omega \cdot \text{cm}$	8.0E-05	6.0E-05	5.0E-05
保存期限	2 ~ 8°C	月	3.0	2.0	

